

DEEPX首席执行官Lokwon Kim将在CES 2024小组讨论上发表演讲

Lokwon Kim 将代表全球AI芯片公司参加一场有关实现设备端AI时代创新的专题讨论会

- DEEPX首席执行官Lokwon Kim将在CES 2024小组讨论中讨论设备端AI的时间安排和计划
- DEEPX将在北厅8953号展位展出超低功耗AI芯片解决方案

拉斯维加斯和韩国首尔2024年1月9日 /美通社/ -- 领先的原创人工智能(AI)芯片公司DEEPX欣然宣布将参加1月9日至12日在美国拉斯维加斯举行的备受推崇的全球IT和电子产品展览会CES 2024 (2024年国际消费电子展)。DEEPX将在首席执行官Lokwon Kim的带领下，通过创新的AI芯片，展示超低功耗设备端AI解决方案的未来。



DEEPX CEO Lokwon Kim

欲了解DEEPX的超低功耗AI芯片解决方案，请访问CES 2024北厅8953号展位。

CES 2024将成为设备端AI的关键一年，英特尔和高通等行业巨头将发表主题演讲，并就人工智能的变革潜力展开讨论。DEEPX将在CES上发布"AI-in-4人工智能整体解决方案"，由四款突破性产品组成，并辅以实现设备端AI的实时技术演示。



值得一提的是，DEEPX首席执行官Lokwon Kim还受邀与人工智能硬件和半导体领域的全球知名人士共同探讨人工智能硬件、半导体技术和市场趋势。这场题为“人工智能的难点：硬件和芯片”(The Hard Part of AI: Hardware and Chips)的演讲将于当地时间1月10日（星期三）上午9:00至9:40，在拉斯维加斯会议中心北厅N250举行。对话将探讨全球对设备端机器视觉和边缘人工智能的采用、市场对硬件和设备端解决方案的需求，以实现生成式人工智能、创新人工智能芯片和技术融合的大众化，以及行业的挑战和机遇。

Gartner最近发布的一份2023年报告强调了AI驱动型计算机视觉和边缘AI市场日益增长的重要性，凸显了其塑造未来的潜力。其中，设备端AI（不包括边缘服务器）需要绕过服务器或云来实现AI功能。由于面部识别、语音识别和照片编辑等计算机视觉功能在智能交通和机器人、物联网和物理安全系统等各种设备中的应用，这一市场正在不断扩大。

麦肯锡(McKinsey)预测，到2030年，全球智能交通市场规模将达到1.5万亿美元。Grand View Research的一份报告预测，2030年全球智能家电市场规模将飙升至585.1亿美元。此外，全球摄像头模块市场预计到同年将达到604.4亿美元。摄像头和基于传感器的模块（如雷达、激光雷达和超声波）也需要实时的人工智能计算处理。因此，对实现计算机视觉的人工智能芯片的需求可能会非常大。

然而，由于电池供电的设备环境往往需要更多的冷却技术和硬件资源，因此实现大规模人工智能边缘设备具有挑战性。为了克服这些障碍，DEEPX首创了低功耗、高性能的人工智能芯片源技术，包括INT8模型压缩和高效内存利用（最大限度地减少DRAM和高速缓冲存储器），实现了出色的功耗性能比。

设备端AI的一个突出发展是整合了大型语言模型(LLM)，促进了聊天机器人、翻译、总结、写作和编码等功能的实现。这一转变的驱动因素包括数据隐私、实时处理、降低成本和功耗，以及边缘设备应用的多样化。虽然运行生成式AI模型的AI个人电脑和设备硬件市场刚刚起步，但能满足用户不断变化的需求的轻量级高级生成式AI模型已经呼之欲出。

DEEPX首席执行官Lokwon Kim表示：“这是我们首次参加2024 CES，我们很高兴能通过专属展台展示我们自主研发的技术。能够获得三项CES创新奖，并被选为人工智能芯片公司代表参加CES Panel Talk活动，我们深感荣幸。DEEPX致力实现人工智能的大众化，让世界各地的人都能使用人工智能。我们已成功向全球客户交付了首批半导体原型，并正在为量产和广泛采用做准备。在不久的将来，DEEPX的人工智能芯片将为我们的生活和社会带来巨大的变化，推动智能交通、机器人、自动驾驶汽车、物理安全系统和工厂自动化领域的创新。”

原文地址：http://www.china-nengyuan.com/exhibition/exhibition_news_205575.html